



環球晶圓股份有限公司 公開說明書

股票代碼：6488

(發行 114 年度第 1 期無擔保普通公司債)

- 一、公司名稱：環球晶圓股份有限公司。
- 二、本公開說明書編印目的：發行 114 年度第 1 期無擔保普通公司債。
- 三、發行公司債之種類、金額、利率、發行條件、公開承銷比例、承銷及配售方式：
 - (一)發行種類：環球晶圓股份有限公司 114 年度第 1 期無擔保普通公司債(以下簡稱「本公司債」)。
 - (二)發行金額：本公司債發行總額為新臺幣 75 億元整，依發行條件之不同分為甲、乙及丙券共三券，其中甲券發行金額為新臺幣 33 億元整，乙券發行金額為新臺幣 28 億元整，丙券發行金額為新臺幣 14 億元整。每張票面金額為新臺幣壹佰萬元壹種。
 - (三)發行期間及方式：本公司債甲券為三年期；乙券為五年期；丙券為十年期，依票面金額十足發行。
 - (四)票面利率：本公司債甲券之票面利率為固定年利率 2.01%，乙券之票面利率為固定年利率 2.08%，丙券之票面利率為固定年利率 2.18%。
 - (五)發行條件：參閱本公開說明書第 2 頁。
 - (六)公開承銷比例：百分之百委由承銷商對外公開承銷。
 - (七)承銷及配售方式：委託承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷。
 - (八)銷售對象：僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人。
- 四、本次資金運用計畫之用途及預計可能產生效益概要：本次資金用途為償還債務，可能效益為降低利率風險、鎖定資金成本及提升財務應變彈性；請參閱本公開說明書第 3 頁：參、資金用途。
- 五、本次發行之相關費用：
 - (一)承銷費用：新臺幣 7,500 仟元。
 - (二)其他費用：新臺幣 870 仟元。
- 六、有價證券之生效，不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳。
- 七、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責人與其他曾在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責。
- 八、投資人投資前應至金融監督管理委員會指定之資訊申報網站詳閱本公開說明書之內容，並應注意公司之風險事項。
- 九、本公司股票面額：每股面額為新臺幣 10 元整。
- 十、查詢本公開說明書之網址：公開資訊觀測站網址：<https://mops.twse.com.tw>

環球晶圓股份有限公司 編製

中華民國 114 年 5 月 21 日刊印

一、本次發行前實收資本之來源：

單位：新臺幣元；%

實收資本之來源	金額	占實收資本額比率(%)
設立資本	1,800,000,000	37.65
現金增資	2,992,500,000	62.59
註銷庫藏股減資	(20,130,000)	(0.42)
轉換發行新股	8,767,250	0.18
合計	4,781,137,250	100

二、本公開說明書之分送計畫：

(一)陳列處所：依規定函送有關單位外，另放置於本公司以供查閱。

(二)分送方式：依證券主管機關之規定辦理。

(三)索取方法：請上網至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)查詢。

三、證券承銷商之名稱、地址、網址及電話：

名稱：富邦綜合證券股份有限公司

網址：<https://www.fubon.com/securities/>

地址：台北市仁愛路四段 169 號 3、4 樓 電話：(02)8771-6888

四、公司債保證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

五、公司債受託機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：台北富邦商業銀行股份有限公司 網址：<https://www.fubon.com/banking/>

地址：台北市民生東路三段 138 號 4 樓 電話：(02)2718-6888

六、股票或公司債簽證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

七、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：元大證券股份有限公司股務代理部 網址：<https://www.yuanta.com.tw>

地址：台北市大安區敦化南路二段 67 號地下一樓 電話：(02)2586-5859

八、信用評等機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：中華信用評等股份有限公司

地址：台北市松山區敦化北路 167 號 2 樓 電話：(02)2175-6800

網址：<https://www.taiwanratings.com>

九、公司債簽證會計師及律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

簽證會計師姓名：吳俊源 網址：<https://www.kpmg.com.tw>

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所 電話：(02)8101-6666

地址：台北市信義區信義路五段 7 號 68 樓

簽證律師姓名：蔡宗釗 網址：無

事務所名稱：一誠聯合法律事務所 電話：(02)2325-3748

地址：台北市大安區信義路三段 106 號 2 樓之 2

十、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址及電話：

簽證會計師姓名：黃泳華、吳俊源 網址：<https://www.kpmg.com.tw>

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所 電話：(02)8101-6666

地址：台北市信義區信義路五段 7 號 68 樓

十一、複核律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：不適用。

十二、本公司發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

發言人/職稱：彭欣瑜/董事長特別助理

聯絡電話：(03)577-2255

電子郵件信箱：GWCIR@sas-globalwafers.com

代理發言人/職稱：何禧樂/行銷處協理

聯絡電話：(03)578-3131

電子郵件信箱：GWCIR@sas-globalwafers.com

十三、本公司網址：<http://www.sas-globalwafers.com>

目 錄

頁次

壹、公開說明書摘要及發行人基本資料.....	1
------------------------	---

貳、發行辦法.....	2
-------------	---

參、資金用途.....	3
-------------	---

附件一：董事會議事錄

附件二：承銷商總結意見

附件三：證券承銷商出具不收取退佣之聲明書

註：依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第二十條，發行人申報發行普通公司債，如銷售對象僅限財團法人櫃檯買賣中心國際債券管理規則所定之專業投資人者，所檢具之公開說明書應依公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則第六條第三項規定辦理，應載明發行人基本資料、發行辦法及資金用途。

壹、公開說明書摘要及發行人基本資料

環球晶圓股份有限公司公開說明書摘要

實收資本額：新台幣4,781,137,250元			公司地址：新竹科學園區新竹市工業東二路八號			電話：(03)577-2255		
設立日期：100年10月18日				網址：http://www.sas-globalwafers.com				
上市日期：不適用		上櫃日期：104年9月25日		公開發行日期：103年9月24日		管理股票日期：不適用		
負責人：董事長 徐秀蘭				發言人：彭欣瑜 職稱：董事長特別助理 代理發言人：何禧樂 職稱：行銷處協理				
股票過戶機構：元大證券股份有限公司股務代理部				電話：(02)2586-5859 網址：https://www.yuanta.com.tw 地址：台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓				
股票承銷機構：不適用				電話：(02)8771-6888 網址：https://www.fubon.com/securities/				
公司債承銷機構：富邦綜合證券股份有限公司				地址：台北市大安區仁愛路四段169號3、4樓				
最近年度簽證會計師：安侯建業聯合會計師事務所 黃泳華、吳俊源會計師				電話：(02)8101-6666 網址：https://www.kpmg.com.tw 地址：台北市信義區信義路五段7號68樓				
複核律師：不適用				電話：不適用 網址：不適用 地址：不適用				
信用評等機構：中華信用評等股份有限公司				電話：(02)2175-6800 網址：https://www.taiwanratings.com 地址：台北市松山區敦化北路167號2樓				
評等標的	發行公司：環球晶圓股份有限公司			無□；有■，評等日期：114年3月26日 評等等級：twAA-				
	本次發行公司債：			無■；有□，評等日期：不適用 評等等級：不適用				
董事選任日期：113年6月18日，任期：3年				監察人選任日期：已設置審計委員會，故不適用				
全體董事持股比例：46.96%（114年4月30日）				全體監察人持股比率：不適用				
董事、監察人及持股超過10%股東及其持股比例：（114年4月30日）								
職 稱	姓 名			持 股 比 例	職 稱	姓 名		持 股 比 例
董事長	徐秀蘭			0.18%	獨立董事	吳琮璿		-
董 事	中美矽晶製品(股)公司			46.64%	獨立董事	蔡子萱		-
	代表人：盧明光				獨立董事	于明仁		-
董 事	中美矽晶製品(股)公司			46.64%	獨立董事	羅達賢		-
	代表人：姚宕梁				10%大股東	中美矽晶製品(股)公司		46.64%
董 事	陳國洲			0.14%				
工廠地址：新竹科學園區新竹市工業東二路八號 電話：(03)577-2255								
主要產品：3吋~12吋半導體晶圓				市場結構：內銷20.54% 外銷79.46%				參閱本文之頁次
								-
風 險 事 項		不適用						參閱本文之頁次
								-
去（113）年度		營業收入：62,626,004仟元 稅前純益：12,428,566仟元 每股盈餘：21.06元				參閱本文之頁次		
						-		
本 次 募 集 發 行 有 價 證 券		發行114年度第1期無擔保普通公司債，發行總額為新臺幣柒拾伍億元，每張票						
種 類 及 金 額		面金額為新臺幣壹佰萬元整。（請參閱本公開說明書封面）						
發 行 條 件		本公司債依發行年期之不同分為甲、乙及丙券共三券，其中甲券為三年期，票面利率2.01%；乙券為五年期，票面利率2.08%；丙券為十年期，票面利率2.18%。（請參閱本公開說明書封面及第2頁）						
募 集 資 金 用 途 及 預		資金用途為償還債務，預計效益為降低利率風險、鎖定資金成本及提升財務應變						
計 產 生 效 益 概 述		彈性。預計產生效益請參閱本公開說明書參、資金用途。						
本次公開說明書刊印日期：114年5月21日				刊印目的：發行114年度第1期無擔保普通公司債				
其他重要事項之扼要說明及參閱本文之頁次：請參閱本公開說明書目錄								

貳、發行辦法

環球晶圓股份有限公司(以下簡稱「本公司」)經呈奉 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃債字第 11400040701 號函通知申報生效發行公司債，訂定發行辦法如下：

- 一、債券名稱：環球晶圓股份有限公司 114 年度第 1 期無擔保普通公司債（以下簡稱「本公司債」）。
- 二、發行總額：本公司債發行總額上限為新臺幣（以下同）75 億元整，依發行條件之不同分為甲、乙及丙券共三券，其中甲券發行金額為 33 億元整、乙券發行金額為 28 億元整、丙券發行金額為 14 億元整。
- 三、票面金額：本公司債票面金額為新臺幣壹佰萬元整。
- 四、發行期間：本公司債甲券發行期間為三年期、乙券發行期間為五年期、丙券發行期間為十年期，發行期間分別為：
甲券自民國114年5月28日發行，至民國117年5月28日到期；
乙券自民國114年5月28日發行，至民國119年5月28日到期；
丙券自民國114年5月28日發行，至民國124年5月28日到期。
- 五、票面利率：本公司債甲券之票面利率為固定年利率 2.01%；乙券之票面利率為固定年利率 2.08%；丙券之票面利率為固定年利率 2.18%。
- 六、發行價格：本公司債於發行日依票面金額十足發行。
- 七、計、付息方式：本公司債自發行日起依票面利率，每年單利計息乙次，每年付息乙次。本公司債每壹佰萬元票面金額債券付息計算至元為止，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付利息。
- 八、還本方式：本公司債各券皆為自發行日起到期一次還本。
- 九、擔保方式：本公司債為無擔保普通公司債。
- 十、債券形式：本公司債採無實體發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。
- 十一、受託人：本公司債由台北富邦商業銀行股份有限公司為債權人之受託人，代表債權人之利益，行使查核監督本公司履行公司債發行事項之權責，並訂立受託契約。凡持有本公司債之債權人，不論係於發行時認購或中途買受者，對於受託契約規定受託人之權利義務及本公司債發行辦法均予同意承認，並授與有關受託事項全權之代理，此項授權並不得中途撤銷，至於受託契約內容，債權人得在規定營業時間內隨時至發行公司或受託人營業處所查閱。
- 十二、還本付息代理機構：本公司債委託台北富邦商業銀行股份有限公司代理還本付息事宜，並依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業，且由還本付息代理機構製作扣繳憑單，寄發予債券所有人。
- 十三、承銷機構：委託承銷商對外公開承銷，並委任富邦綜合證券股份有限公司為主辦承銷商。
- 十四、通知方式：有關本公司債應通知債權人之事項，除法令另有規定者外，均於公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)公告。
- 十五、銷售對象：僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人。

參、資金用途

一、本次發行公司債資金運用計畫分析

(一)資金來源：

- 1.目的事業主管機關核准日期及文號：不適用。
- 2.本計畫所需資金總額：新臺幣 75 億元整。
- 3.資金來源：發行 114 年度第 1 期無擔保普通公司債。
- 4.計畫項目及預定運用進度：

計畫項目	預定完成日期	所需資金總額	單位：新臺幣仟元
			預定資金運用進度
			114 年度 第二季
償還債務	114 年度第二季	7,500,000	7,500,000

(二)本次發行公司債依公司法第二百四十八條規定，揭露有關事項及償還款項之募集計畫與保管方法：

- 1.公司名稱：環球晶圓股份有限公司。
- 2.債券名稱：環球晶圓股份有限公司 114 年度第 1 期無擔保普通公司債(以下簡稱「本公司債」)。
- 3.公司債總額及債券每張之面額：本公司債發行總額為新臺幣（以下同）75 億元整，依發行條件之不同分為甲、乙及丙券共三券，其中甲券發行金額為 33 億元整、乙券發行金額為 28 億元整、丙券發行金額為 14 億元整，每張票面金額為新臺幣壹佰萬元整。
- 4.公司債之利率：本公司債甲券之票面利率為固定年利率 2.01%；乙券之票面利率為固定年利率 2.08%；丙券之票面利率為固定年利率 2.18%。
- 5.公司債償還方法及期限：本公司債甲券發行期間為三年期、乙券發行期間為五年期、丙券發行期間為十年期，皆自發行日起到期一次還本，依票面利率，每年單利計、付息乙次。
- 6.償還公司債款之募集計畫及保管方法：
 - (1)本次公司債存續期間之償債款項來源，將由自有資金、營業收入、銀行借款、貨幣市場或資本市場籌資支應。
 - (2)為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估風險及必要性。
 - (3)本公司將依規定持續於公開訊觀測站辦理相關資訊之公開。
- 7.公司債券募得價款之用途及運用計畫：償還債務。
- 8.前已募集公司債者，其未償還之數額：截至 114 年 3 月 31 日止，未償還之無擔保普通公司債為新臺幣 16,900,000 仟元整。(截至公開說明書刊印日止無異動)
- 9.公司債發行價格：本公司債於發行日依票面金額十足發行。
- 10.公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司章程額定股本總額為新臺幣 10,000,000 仟元整，截至 114 年 3 月 31 日已發行股份總數為 478,113,725 股，每股面額均為新臺幣 10 元，實收資本額為新臺幣 4,781,137,250 元。(截至公開說明書刊印日止無異動)
- 11.公司現有全部合併資產減去全部合併負債後之餘額：截至 114 年 3 月 31 日止為新臺幣 91,676,792 仟元整。
- 12.證券管理機關規定之財務報表：不適用。

- 13.公司債權人之受託人名稱及其約定事項：本公司債由台北富邦商業銀行股份有限公司為債權人之受託人，代表債權人之利益，行使查核監督本公司履行公司債發行事項之權責，並訂立受託契約。凡持有本公司債之債權人，不論係於發行時認購或中途買受者，對於受託契約規定受託人之權利義務及本公司債發行辦法均予同意承認，並授與有關受託事項全權之代理，此項授權並不得中途撤銷。
- 14.代收款項之銀行或郵局名稱及地址：不適用。
- 15.有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：由富邦綜合證券股份有限公司擔任主辦承銷商，依簽訂之承銷契約辦理相關事宜。
- 16.有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。
- 17.有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。
- 18.對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。
- 19.可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。
- 20.附認股權者，其認購辦法：不適用。
- 21.董事會之議事錄：本公司民國 114 年 2 月 25 日董事會會議紀錄。
- 22.公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。
- 23.還本付息代理機構名稱：台北富邦商業銀行股份有限公司。
- 24.發行公司信用評等：
信用評等機構：中華信用評等股份有限公司。
信用評等日期：民國 114 年 3 月 26 日。
信用評等結果：twAA-。

(三)本次計畫之可行性、必要性及合理性，並應分析各種資金調度來源對公司申報年度及未來一年度每股盈餘稀釋影響

1.本次發行公司債之可行性評估：

本次公司債之計畫發行總額為新臺幣75億元，每張面額為新臺幣壹佰萬元，按面額發行。本次發行參酌資本市場狀況訂定，且本公司債承銷方式採承銷團全數包銷並以洽商銷售方式洽專業投資人認購，足以確保本次資金募集之完成，故本次募集資金計畫應屬可行。

2.本次發行公司債之必要性評估：

本次發行固定利率之無擔保普通公司債用於償還債務，可降低利率變動風險，鎖定資金成本，並提高資金運用之穩定性，符合穩健經營之原則，對本公司營運發展具正面助益實屬必要。

3.本次發行公司債之合理性評估：

本次發行無擔保普通公司債係運用資本市場多元化之籌資管道，以固定利率穩定資金取代部份短期融資，降低利率風險，有助提升公司財務應變彈性，故本次發行固定利率之普通公司債應屬合理。

4.分析各種資金調度來源對公司申報年度及未來一年度每股盈餘稀釋影響：

(1)各種籌資工具籌資成本與有利不利因素比較表

綜觀上市(櫃)公司主要資金調度來源，大致分為債權及股權之相關籌資工具，前者有銀行借款、普通公司債及國內外轉換公司債等，後者如現金增資發行新股及海外存託憑證。茲就各種資金調度來源比較分析有利及不利因素如下：

項目		有利因素	不利因素
股	現金增資 發行新股	1.改善財務結構，降低財務風險，提升市場競爭力。 2.係為資本市場較為普遍之金融商品，一般投資者接受程度高。 3.員工依法得優先認購10%~15%，可提升員工之認同感及向心力。	1.每股盈餘易因股本膨脹而被稀釋。 2.對於股權較不集中之公司，其經營權易受威脅。 3.承銷價與市價若無合理差價，則不易籌集成功。
	海外存託憑證	1.經由海外市場募集資金，可拓展公司之知名度。 2.籌資對象以國外法人為主，避免國內籌碼膨脹太多，對股價產生不利影響。 3.提高自有資本比率，改善財務結構。	1.公司海外知名度及其產業成長性影響資金募集計畫成功與否。 2.固定發行成本較高，為符合經濟規模，發行額度不宜過低。
債	國內外轉換公司債	1.因其附有「轉換權」，票面利率較長期性借款為低。 2.轉換公司債換成普通股之轉換價格，一般皆高於發行轉換公司債時普通股之時價，發行公司相當於以較高價格溢價發行股票。 3.稀釋每股盈餘之壓力較低。 4.轉換債經債權人請求轉換後，即由負債轉變成資本，除可節省利息支出外，亦可避免到期還本之龐大資金壓力。	1.流通性較普通股低。 2.未轉換，仍有贖回之資金壓力。
	普通公司債	1.對股權沒有稀釋效果。 2.債權人對公司不具管理權，對公司經營權掌握，不會造成重大影響。 3.有效運用財務槓桿，創造較高之利潤。	1.利息負擔侵蝕公司獲利。 2.影響財務結構，降低競爭力。 3.公司債期限屆滿後，公司即面臨龐大資金贖回壓力。
	銀行借款 或發行承兌匯票	1.對股權沒有稀釋效果。 2.債權人對公司不具管理權，對公司經營權掌握，不會造成重大影響。 3.有效運用財務槓桿，創造較高之利潤。	1.利息負擔侵蝕公司獲利。 2.影響財務結構，降低競爭能力。 3.到期有還款壓力。

(2)各種資金調度來源對本公司每股盈餘稀釋之影響

基於上述各項籌資方式分析，本公司以普通公司債籌集資金，除可掌握穩定資金來源，亦可避免每股盈餘過度稀釋，有助於未來業務競爭力之提昇，並降低營運風險。本次發行普通公司債係用以償還債務，鎖定資金成本，無股本膨脹之虞，對每股盈餘無重大影響。

5.以低於票面金額發行股票者，應說明公司折價發行新股之必要性與合理性、未採用其他籌資方式之原因與其合理性及所沖減資本公積或保留盈餘之數額：不適用。

(四)本次發行價格之訂定方式：經本公司董事會決議，並參考櫃買中心公佈之殖利率曲線與同期指標公債暨同期利率交換合約，再依據投資人對未來利率判斷後審慎定價。

(五)資金運用概算及可能產生之效益：

1.收購其他公司、擴建或新建不動產、廠房及設備，應說明本次計畫完成後，預計可能增加之產銷量、值、成本結構(含總成本及單位成本)、獲利能力之變動情形、產品品質之改善情形及其他可能產生之效益：不適用。

2.如為轉投資其他公司者

(1)轉投資事業最近二年度之稅後淨利、轉投資之目的、資金計畫用途及其所營事業與公司業務之關聯性、預計投資損益情形及對公司經營之影響：不適用。

(2)如轉投資特許事業者應敘明特許事業主管機關核准或許可情形及核准或許可之附帶事項是否有影響本次募集與發行有價證券：不適用。

3.如為充實營運資金、償還債務者

(1)公司債務逐年到期金額、償還計畫及預計財務負擔減輕情形、目前營運資金狀況、所需之資金額度及預計運用情形：

A.公司債逐年到期金額及償還計畫：

本公司債存續期間之還款資金來源將由自有資金、營業收入、銀行借款、貨幣市場或資本市場籌資支應。

單位：新台幣仟元

到期年度 債券名稱	115年度	117年度	118年度	119年度	120年度	124年度
110年度第1期無擔保普通公司債	6,500,000					
110年度第2期無擔保普通公司債	5,400,000					
113年度第1期無擔保普通公司債			2,500,000		2,500,000	
114年度第1期無擔保普通公司債 (本次預計發行)		3,300,000		2,800,000		1,400,000

B.預計財務負擔減輕情形：

本次募資計畫，預計於114年度第二季募集完成，用以調整財務結構及償還下列債務，本次發行以新臺幣計價固定利率之公司債，主係考量目前全球金融環境波動劇烈，藉由本次發行固定利率之公司債雖未能減少利息費用，但可降低利率波動風險、鎖定資金成本，並可提高長期資金來源及強化財務結構，對本公司整體營運發展具正面助益。

單位：新臺幣仟元；%

貸款機構	利率 (%)	契約期間	原貸款 用途	原貸款 金額	114 年度		合計	
					第二季			
					償還 金額	減少 利息	償還 金額	減少 利息
大慶票券	1.638%	114/5/14-114/5/28	營運週轉	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	-
中華票券	1.638%	114/5/14-114/5/28	營運週轉	4,910,000	4,910,000	-	4,910,000	-
法國巴黎銀行	1.710%	114/4/22-114/5/28(註)	營運週轉	1,090,000	1,090,000	-	1,090,000	-
合計				7,500,000	7,500,000	-	7,500,000	-

註：將於 114/5/22 衡酌短期利率，若以其他金融機構借款償還，將於同年 5/28 以公司債募集資金償還該金融機構借款。

C.目前營運資金狀況：本公司至 114 年 3 月 31 日止，合併財務報告之現金及約當現金為新臺幣 28,845,567 仟元，流動資產扣除流動負債之餘額為新臺幣 9,808,618 仟元。

D.所需資金額度與預計運用情形：

單位：新臺幣仟元

計畫項目	預定完成日期	所需資金總額	預定資金運用進度
			114 年度
			第二季
償還債務	114 年度第二季	7,500,000	7,500,000

(2)用於充實營運資金者，預計產生效益之具體說明：不適用。

(3)申報年度及未來一年度各月份之現金收支預測表：請參見第10~11頁。

(4)就本公司申報年度及預計未來一年度應收帳款收款與應付帳款付款政策、資本支出計畫、財務槓桿及負債比率(或自有資產與風險性資產比率)，說明償債或充實營運資金之原因：

A.應收帳款：本公司對往來客戶之授信條件依本公司相關辦法具體評估後給予適當額度，主要銷售客戶之交易條件介於月結 30~120 天。

B.應付帳款：於廠商交貨後，經檢驗合格後辦理入庫，付款天期一般為 30~150 天。

C.資本支出計畫：

單位：新臺幣

114 年度(預估)	115 年度(預估)
約 1,845,703 仟元	約 2,246,442 仟元

D.財務槓桿及負債比率

項目/年度	114 年度(預估)	115 年度(預估)
財務槓桿	1.07	1.08
負債比率(%)	37.20%	37.55%

E.償債或充實營運資金原因

本次發行公司債用以償還債務，可鎖定資金成本，減少貨幣市場資金緊俏及利率變動風險，並可取代銀行短期融資，增加籌資管道，提升本公司資金調度能力，對本公司長期營運發展具正面助益，符合穩健經營原則。

(5)發行計畫如用於償債，應說明原借款用途及其效益達成情形：本公司本次發行普通公司債，係用於償還銀行借款，原借款用途係支應營運週轉資金所需，其主要效益為強化公司營運資金週轉能力，提升公司穩定性，藉此提高市場整體競爭力及公司獲利。

(6)現金收支預測表中，未來如有重大資本支出及長期股權投資合計之金額達本次募資金額百分之六十者，應敘明其必要性、預計資金來源及效益。

單位：新台幣仟元

項目	實際或預計之 資金來源	114 年度			115 年度
		1~4 月 (實際數)	5~12 月 (預估數)	合計 (預估數)	合計 (預估數)
購置不動產、廠房及設備款	自有資金	115,052	1,730,651	1,845,703	2,246,442
長期股權投資	自有資金	0	6,398,000	6,398,000	6,398,000

本公司編制之申報年度及未來一年度之現金收支預測表，其中所編列之資本支出預算，主要用途有二，其一係為了維持設備正常產出，每年必須編列相當金額之資本支出，作為設備保養維修及汰舊換新之必要支出；其次，為了符合節能減碳政策及公司RE100的宣示，公司在未來二年預計大幅增加節能相關設備。此資本支出項目，除了能讓公司維持產線正常運作外，節能設施的導入亦能節省能源費用及碳費的支出，也讓公司善盡社會責任，除具經濟效益外，亦有其必要性與正當性。上述資本支出資金來源係以自有資金支應。

本公司編制之申報年度及未來一年度之現金收支預測表，其中未來於114年6月有長期股權投資支出新台幣6,398,000仟元（美金2億元），以及於115年9月有長期股權投資支出新台幣6,398,000仟元（美金2億元），其用途係為增資本公司荷蘭子公司GlobalWafers B.V.（以下簡稱GWBV），後續再經由GWBV及/或其項下海外子公司增資美國子公司GlobalWafers America, LLC（以下簡稱GWA），擬用於支應GWA當地的擴廠資金需求並充實其營運資金。GWBV為本公司直接持股100%之子公司並為本公司統整海外事業的投資與策略布局之主要投資主體，GWA為其間接持股100%之孫公司。GWA為集團於美國德州謝爾曼市新建之12吋先進製程矽晶圓製造廠，目前已進入樣品製作與交付階段，新產能將逐步提升，量產後將提高本公司在12吋先進製程晶圓的產能，優化公司的產品組合，可挹注集團營收及獲利，擴大海外半導體事業經營規模，並強化集團於美國本土的晶圓製造與在地供應能力，上述長期股權投資之資金來源係以自有資金支應。

4.購買營建用地、支付營建工程款或承攬工程者，應詳列預計自購買土地至營建個案銷售完竣或承攬工程完竣所需之資金總額、不足資金之來源及各階段資金投入及工程進度，並就認列損益之時點、金額說明預計可能產生效益：不適用。

5.購買未完工程並承受賣方未履行契約者，應列明買方轉讓理由、受讓價格決定依據及受讓過程對契約相對人權利義務之影響：不適用。

二、本次受讓他公司股份發行新股應記載事項：不適用。

三、本次併購發行新股應記載事項：不適用。

114 年度各月份之現金收支預測表

單位：新臺幣仟元

項目	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合計
期初現金餘額(1)	13,755,894	6,102,474	6,449,050	8,215,628	5,977,690	11,576,965	6,040,660	6,825,920	4,678,522	4,607,403	5,051,121	5,627,866	13,755,894
加：非融資性收入													
應收票據及帳款收現	1,780,134	3,130,197	3,006,246	2,695,869	2,708,729	2,744,790	2,704,181	2,802,959	2,350,461	2,861,555	2,968,189	3,053,063	32,806,373
其他收入	30,487	19,909	31,247	446,588	13,557	13,657	13,387	13,161	12,959	13,855	14,996	16,511	640,313
合計(2)	1,810,621	3,150,106	3,037,494	3,142,457	2,722,286	2,758,447	2,717,567	2,816,120	2,363,419	2,875,409	2,983,185	3,069,574	33,446,686
減：非融資性支出													
應付票據及帳款付現	1,674,797	2,280,220	1,982,407	2,032,632	1,671,139	1,613,887	1,719,090	1,713,321	1,315,332	1,828,590	1,819,665	1,788,038	21,439,119
薪資付現	260,607	93,823	133,874	97,322	133,500	140,000	105,000	105,000	140,000	133,500	196,672	120,000	1,659,298
各項費用	40,397	4,129	129,860	6,255	24,231	23,877	24,231	24,231	23,877	24,231	23,877	24,231	373,430
所得稅付現	-	-	-	-	754,125	-	-	-	868,255	-	-	-	1,622,380
購置不動產、廠房及設備	33,120	14,171	24,775	42,986	150,015	118,988	83,985	102,283	87,075	445,370	366,225	376,709	1,845,703
長期投資	-	-	-	-	-	6,398,000	-	-	-	-	-	-	6,398,000
配發現金股利及董事酬勞	-	2,311,187	-	-	-	-	-	3,018,682	-	-	-	-	5,329,870
合計(3)	2,008,921	4,703,530	2,270,916	2,179,195	2,733,010	8,294,753	1,932,307	4,963,518	2,434,539	2,431,691	2,406,440	2,308,979	38,667,799
要求最低現金餘額(4)	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
所需資金總額(5)=(3)+(4)	4,008,921	6,703,530	4,270,916	4,179,195	4,733,010	10,294,753	3,932,307	6,963,518	4,434,539	4,431,691	4,406,440	4,308,979	40,667,799
融資前可供支用現金餘額	11,557,594	2,549,050	5,215,628	7,178,890	3,966,965	4,040,660	4,825,920	2,678,522	2,607,403	3,051,121	3,627,866	4,388,461	6,534,781
(6)=(1)+(2)-(5)	-	-	-	-	7,500,000	-	-	-	-	-	-	-	7,500,000
發行公司債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
償還公司債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
借(還)款淨額	(4,200,000)	1,900,000	1,000,000	(3,010,000)	(1,890,000)	-	-	-	-	-	-	-	(6,200,000)
資金貸與	(3,255,120)	-	-	(191,200)	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,446,320)
合計(7)	(7,455,120)	1,900,000	1,000,000	(3,201,200)	5,610,000	-	-	-	-	-	-	-	(2,146,320)
期末現金餘額	6,102,474	6,449,050	8,215,628	5,977,690	11,576,965	6,040,660	6,825,920	4,678,522	4,607,403	5,051,121	5,627,866	6,388,461	6,388,461
(8)=(1)+(2)-(3)+(7)													

115 年度各月份之現金收支預測表

單位：新臺幣仟元

項目	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合計
期初現金餘額(1)	6,388,461	7,119,594	5,383,207	6,367,287	7,097,594	6,971,824	11,409,132	12,226,088	10,678,432	4,094,666	4,214,565	4,329,916	6,388,461
加：非融資性收入													
應收票據及帳款收現	2,930,456	3,045,709	2,955,590	3,024,727	3,315,625	3,266,600	3,195,514	3,321,408	2,460,983	3,265,507	3,392,540	3,471,115	37,645,775
其他收入	16,036	13,083	14,875	16,188	15,888	17,555	18,996	16,098	15,742	17,813	19,883	22,367	204,525
合計(2)	2,946,492	3,058,792	2,970,465	3,040,915	3,331,513	3,284,155	3,214,511	3,337,507	2,476,725	3,283,320	3,412,424	3,493,482	37,850,300
減：非融資性支出													
應付票據及帳款付現	1,851,456	1,851,335	1,677,332	1,879,579	1,991,325	1,855,970	1,979,566	1,973,888	1,271,032	2,016,605	2,001,738	1,958,227	22,308,052
薪資付現	105,000	202,000	120,000	105,000	105,000	168,500	105,000	105,000	168,500	105,000	205,484	120,000	1,614,484
各項費用	24,231	23,168	24,231	23,877	31,436	34,081	34,436	40,511	40,156	40,511	39,406	39,011	395,055
所得稅付現	-	-	-	-	1,052,054	-	-	-	953,288	-	-	-	2,005,342
購置不動產、廠房及設備	234,671	178,107	164,822	302,152	277,469	288,295	278,554	225,195	229,514	1,305	50,445	15,912	2,246,442
長期投資	-	-	-	-	-	-	-	-	6,398,000	-	-	-	6,398,000
配發現金股利及董事酬勞	-	2,540,569	-	-	-	-	-	2,540,569	-	-	-	-	5,081,137
合計(3)	2,215,359	4,795,179	1,986,385	2,310,607	3,457,283	2,346,846	2,397,555	4,885,163	9,060,491	2,163,421	2,297,073	2,133,150	40,048,513
要求最低現金餘額(4)	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
所需資金總額(5)=(3)+(4)	4,215,359	6,795,179	3,986,385	4,310,607	5,457,283	4,346,846	4,397,555	6,885,163	11,060,491	4,163,421	4,297,073	4,133,150	42,048,513
融資前可供支用現金餘額(6)=(1)+(2)-(5)	5,119,594	3,383,207	4,367,287	5,097,594	4,971,824	5,909,132	10,226,088	8,678,432	2,094,666	3,214,565	3,329,916	3,690,248	2,190,248
發行公司債	-	-	-	-	6,500,000	-	-	5,400,000	-	-	-	-	11,900,000
償還公司債	-	-	-	-	(6,500,000)	-	-	(5,400,000)	-	-	-	-	(11,900,000)
借(還)款	-	-	-	-	-	3,500,000	-	-	-	(1,000,000)	(1,000,000)	(1,000,000)	500,000
合計(7)	-	-	-	-	-	3,500,000	-	-	-	(1,000,000)	(1,000,000)	(1,000,000)	500,000
期末現金餘額(8)=(1)+(2)-(3)+(7)	7,119,594	5,383,207	6,367,287	7,097,594	6,971,824	11,409,132	12,226,088	10,678,432	4,094,666	4,214,565	4,329,916	4,690,248	4,690,248

附件一：董事會議事錄

環球晶圓股份有限公司
第六屆第五次董事會議事錄（節錄本）



壹、時間：中華民國 114 年 2 月 25 日(星期二)上午 10 時 40 分

地點：新竹科學園區新竹市工業東二路八號四樓會議室

貳、出席董事：

一、出席者：實際出席董事共計 8 人

董事 徐秀蘭

中美矽晶製品(股)公司代表人 盧明光

中美矽晶製品(股)公司代表人 姚宕梁

陳國洲

獨立董事 于明仁

羅達賢

吳琮璠

蔡子萱

二、列席者：共 6 人

企業發展副總 李崇偉

財務主管 簡明輝

會計主管 羅玉婷

稽核主管 鄭夙媛

安侯建業聯合會計師事務所 黃泳華會計師及吳俊源會計師

參、主席：徐秀蘭 董事長

肆、報告事項（略）

伍、討論事項

上次會議保留之討論事項：無

本次會議預定討論事項：

一~九、（略）

十、案由：本公司擬發行國內無擔保普通公司債案，提請 討論。

說明：（一）發行條件擬訂如下：

（1）名稱：環球晶圓股份有限公司無擔保普通公司債。

（2）發行總額及面額：發行總額不超過新台幣 285 億元，每張票面金額新台幣 100 萬元。額度自董事會決議日起二年內有效。（本公司前於 112 年 11 月 7 日第五屆第十六次董事會決議通過發行無擔保普通公司債總額不超過新台幣 140 億元，剩餘未發行額度併入本次申請額度計算。）

- (3)發行期間及方式：得視市場狀況發行不同年期之債券，並得分次按面額發行。
- (4)票面利率：採固定利率或浮動利率發行。
- (5)計付息方式：自發行日起依票面利率，每年單利計、付息一次。
- (6)還本方式：得分次還本或到期一次還本。
- (7)擔保方式：無。
- (8)資金用途：募集中長期資金，用以償還債務及/或充實營運資金及/或轉投資國內及/或海外事業及/或購置機器設備及/或支應綠色投資計畫。
- (二)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次無擔保普通公司債籌資計畫有關之發行條件、發行辦法之訂定，資金來源、計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益及其他相關事宜，未來如經主管機關修正或基於營運評估或因客觀環境需要修正或調整時，授權董事長或其指定之人依市場狀況決行之。
- (三)為配合本次發行無擔保普通公司債案之募集與發行作業，擬授權董事長或其指定之人核可並代表本公司議定、簽署及交付一切相關發行無擔保普通公司債所需之契約及其他文件，並全權為本公司辦理一切相關事宜。
- (四)本次發行之公司債於申請經金融監督管理委員會證券期貨局或其委託之機構核准募集並發行後，授權董事長於符合相關法令之前提下，向中華民國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣。
- (五)本次發行如有未盡事宜，擬授權董事長或其指定之人全權處理之。
- (六)本公司歷年發行無擔保普通公司債情形，請參閱附件二十一。
- (七)本案於 114 年 2 月 25 日由本公司第四屆第四次審計委員會審議並提請董事會決議。
- (八)敬請 討論。

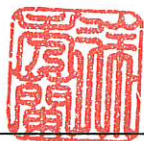
決議：經全體出席董事無異議照案通過。

十一~十二、(略)

陸、臨時動議：無。

柒、散會

主席：徐秀蘭



記錄：簡明輝



附件二：承銷商總結意見

承銷商總結意見

(發行普通公司債委託證券承銷商對外公開銷售且銷售對象僅限專業投資人者適用)

環球晶圓股份有限公司本次為發行 114 年度第 1 期無擔保普通公司債，以面額新臺幣壹佰萬元發行，發行總額為新臺幣柒拾伍億元整，並委託本承銷商對外公開銷售，向 金融監督管理委員會提出申報，業依規定填報案件檢查表，並經本承銷商採取必要程序予以複核，特依「證券商管理規則」及「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，出具本承銷商總結意見。

依本承銷商之意見，環球晶圓股份有限公司本次募集與發行普通公司債委託證券承銷商對外公開銷售符合「發行人募集與發行有價證券處理準則」及相關法令之規定，暨其計畫具可行性及必要性，其資金用途、進度及預計可能產生效益亦具合理性。

此致

環球晶圓股份有限公司

富邦綜合證券股份有限公司



負責人：程明乾



承銷部門主管：黃靖樺



中 華 民 國 1 1 4 年 5 月 15 日

附件三：證券承銷商出具不收取退佣之聲明書

聲明書

本公司受環球晶圓股份有限公司（下稱環球晶）委託，擔任環球晶募集與發行 114 年度第 1 期無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、環球晶本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：富邦綜合證券股份有限公司

負責人：程明乾



中 華 民 國 1 1 4 年 5 月 15 日

聲明書

本公司受環球晶圓股份有限公司(下稱環球晶)委託,擔任環球晶募集與發行 114 年度第 1 期無擔保普通公司債乙案之證券承銷商,茲聲明將善盡注意下列事項,絕無虛偽或隱匿之情事:

- 一、環球晶本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序,應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為,且承銷相關費用之收取,不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者,涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定,除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理,並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商 : 元大證券股份有限公司

負責人 : 董事長 陳修偉

日期 : 114 年 5 月 21 日



聲明書

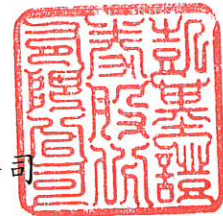
本公司受環球晶圓股份有限公司(下稱環球晶)委託，擔任環球晶募集與發行 114 年度第 1 期無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、環球晶本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：凱基證券股份有限公司

負責人：董事長 許道義

日期：114 年 5 月 21 日



聲明書

本公司受環球晶圓股份有限公司(下稱環球晶)委託,擔任環球晶募集與發行 114 年度第 1 期無擔保普通公司債乙案之證券承銷商,茲聲明將善盡注意下列事項,絕無虛偽或隱匿之情事:

- 一、環球晶本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序,應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為,且承銷相關費用之收取,不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者,涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定,除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理,並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。



證券承銷商：台新國際商業銀行股份有限公司

負責人：總經理 林淑真

日期：114 年 5 月 21 日



聲明書

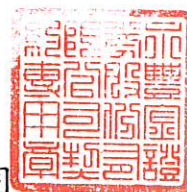
本公司受環球晶圓股份有限公司(下稱環球晶)委託，擔任環球晶募集與發行 114 年度第 1 期無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、環球晶本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：永豐金證券股份有限公司

負責人：董事長 朱士廷

日期：114 年 5 月 21 日



聲明書

本公司受環球晶圓股份有限公司(下稱環球晶)委託,擔任環球晶募集與發行 114 年度第 1 期無擔保普通公司債乙案之證券承銷商,茲聲明將善盡注意下列事項,絕無虛偽或隱匿之情事:

- 一、環球晶本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序,應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為,且承銷相關費用之收取,不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者,涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定,除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理,並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商 : 元富證券股份有限公司

負責人 : 董事長 陳俊宏

日期 : 114 年 5 月 21 日



聲明書

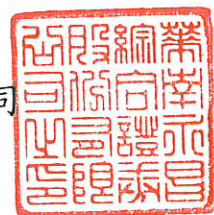
本公司受環球晶圓股份有限公司(下稱環球晶)委託,擔任環球晶募集與發行 114 年度第 1 期無擔保普通公司債乙案之證券承銷商,茲聲明將善盡注意下列事項,絕無虛偽或隱匿之情事:

- 一、環球晶本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序,應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為,且承銷相關費用之收取,不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者,涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定,除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理,並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：華南永昌綜合證券股份有限公司

負責人：董事長 黃進明

日期：114 年 5 月 21 日



環球晶圓股份有限公司

董事長：徐 秀 蘭

